

Mühendislik Destek Yetenekleri

Engineering Support Capabilities



Teknik Dokümantasyon

Üretim için MIL-STD-100 ile uyumlu, satın alınacak parçalar için de MIL-STD-490 referans alınarak SCD/SoCD hazırlanır.

Üretim için Oluşturulan Doküman Tipleri

- Üretim için oluşturulan doküman tipleri
- Drawing tree
- Outline drawing
- Block diagram
- Schematic diagram
- Interconnect-wiring diagram
- Wiring list
- Assembly, mechanical
- Cable assemblies
- Circuit card assembly
- Solid model
- Mechanical piece part; detailed drawing
- Labels
- Fabricated items with hardware, inseparable assemblies
- PCB fabrication drawing
- PCB design drawing

- Installation drawing
- Modification/alterd items drawing
- Text-fixtures / tooling

ELD kapsamında yapılan analizler ve üretilen hizmetler

- Entegre lojistik destek analizleri/ raporları
- Bakım planı analizleri/ raporları
- FMECA analizi/ raporları
- MTBF analizleri/ raporları
- İdame edilebilirlik analizleri/ raporları
- Emniyet analizleri/ raporları
- Test edilebilirlik analizleri/ raporları
- Güvenilirlik analizleri/ raporları
- Yedek parça ve saha destek analizleri/ raporları
- Resimli parça kataloğu
- Kullanıcı ve/veya cihaz bakım analizleri-el kitabı
- Operasyonel el kitabı
- Sözleşmesel müşteri/ kullanıcı eğitimi dokümanları
- Diğer sözleşmesel doküman ve raporlar
- MTBF ve MTTR analizleri için dahili hazırlanan yazılımların yanında lambda predict yazılımı da kullanılmaktadır.

Technical Documentation

Engineering Drawings per MIL-STD-100 and SCD/SoCD per MIL-STD-490.

Engineering Documents

- Engineering documents
- Drawing tree
- Outline drawing
- Block diagram
- Schematic diagram
- Interconnect-wiring diagram
- Wiring list
- Assembly, mechanical
- Cable assemblies
- Circuit card assembly
- Mechanical piece part; detailed drawing
- Fabricated items with hardware, inseparable assemblies
- PCB fabrication drawing

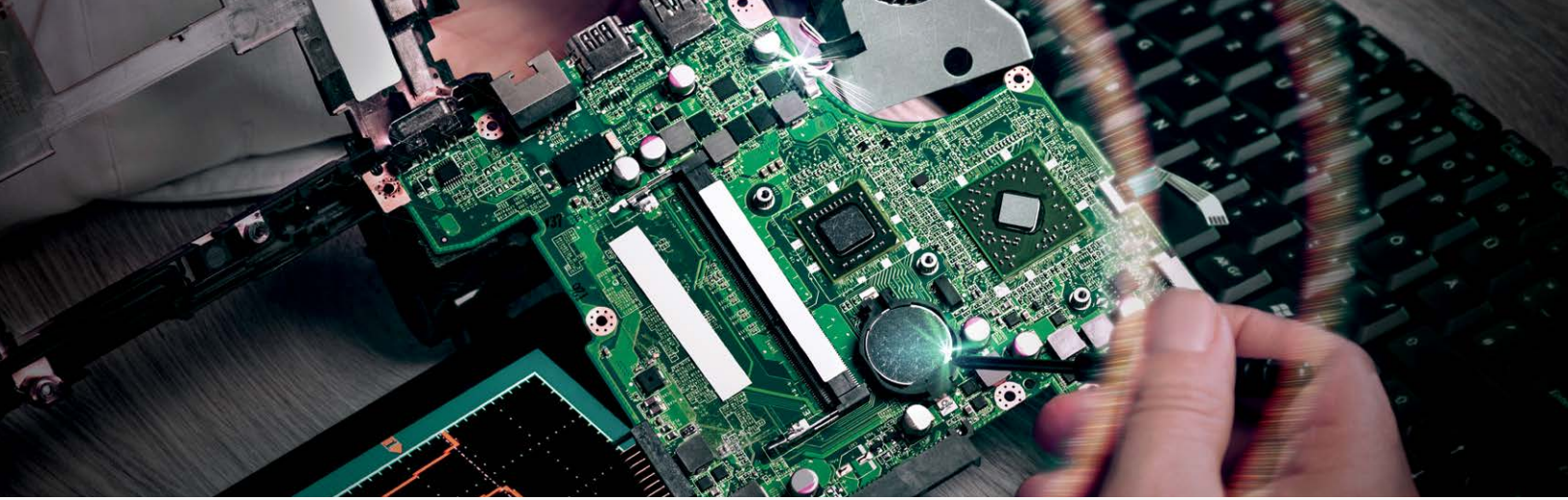
- Installation drawing
- Modification/alterd items drawing

ILS Services

- ILS analyses/reports,
- Maintenance plan analyses/reports,
- FMECA analyses/reports,
- MTBF analyses/reports,
- Supportability analyses/reports,
- Safety analyses/reports,
- Testability analyses/reports,
- Reliability analyses/reports,
- Spare parts and fiels support analyses/reports,
- User and/or equipment maintenance analyses/reports,
- Customer/user training documents.
- Lambda predict and in house developed programs are utilized for MTBF ve MTTR analyses.

Üretim Yetenekleri

Production Capabilities



SDT kendi bünyesi içinde kablaj üretimi, kart dizgi, konformal kaplama ve elektronik kutu montaj işlemlerini yürütmektedir.

Uygulanan standartlar

- MIL-STD-454 işçilik standardı
- MIL-STD-130 ürün tanımlaması ve izlenebilirliği
- Lehim işçiliği için MIL-STD-2000
- IPC-J-STD-001D elektronik üretim standardı
- Kablo ve kablaj takımları için kabul edilebilirlik standardı
- IPC 7711-7721 Rework/ Repair and Modification Program
- IPC /WHMA-A-620 requirements and acceptance for cable and wire harness

Üretim Aktiviteleri

- IPC Standartlarında tanımlı her tür DIP, SMD, BGA elektronik komponent dizgisi

- 0402, 0603, 0805 ve daha büyük direnç ve kapasitör dizgisi
- QFN, QFP, TQFN, TQFP, BGA (0.8 , 1.0 , 1.25 mm pitch size), Chip Scale Package (0,5 mm pitch size) ve daha büyük paketli tüm devre dizgisi
- Micro-D ve Nano-D, 38999 Serisi Konnektörler dahil olmak üzere her tür Wire to Board ve Board to Board konnektör montajı
- IPC Standartlarında kabul kriterleri belirtilmiş, kablaj uygulamaları
- D38999 konnektör kablajı üretimi
- Blendajlı ve shield'lı kablaj üretimi
- EMI test kablajları üretimi
- Cihaz içi kablaj üretimi
- EMI/EMC uyumlu cihaz kutusu ve alt parçaları montajı
- Shock absorber montajı
- Gasket, seal, o-ring montajı
- D-ZUS montajı, vb.

SDT has in-house, harness, electronic board assembly, conformal coating and mechanical assembly capabilities.

The Standards applied

- MIL-STD-454 workmanship standard
- MIL-STD-130 product definition and traceability
- MIL-STD-2000 for soldering process
- IPC-J-STD-001D electronic assembly
- Cable and cable set acceptance standard
- IPC 7711-7721 rework/ repair and modification program
- IPC /WHMA-A-620 requirements and acceptance for cable and wire harness assemblies

Production Activities

- Electronic component assembly per IPC Standards DIP, SMD, BGA etc.

- 0402, 0603, 0805 and larger chip resistors and capacitors
- QFN, QFP, TQFN, TQFP, BGA (0.8 , 1.0 , 1.25 mm pitch size), Chip Scale Package (0,5 mm pitch size)
- Micro-D and Nano-D, 38999 and all type wire to board ve board to board connector assembly
- Harness per IPC Standards
- D38999 Series Connector and Harness Assembly
- Shielded Harness Assembly
- EMI Test Harness assembly
- In-case Harness Assembly
- EMI/EMC compatible device box design and assembly
- Shock absorber mount
- Gasket, seal, o-ring mount
- D-ZUS mount etc